

中国国际金融股份有限公司
关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇二二年四月

目 录

一、发行人基本情况	4
(一) 发行人基本信息	4
(二) 发行人主营业务	4
(三) 发行人核心技术与研发水平	6
(四) 发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标	6
(五) 发行人存在的主要风险	7
二、发行人本次发行情况	12
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况	13
(一) 项目保荐代表人保荐业务主要执业情况	13
(二) 项目协办人保荐业务主要执业情况	14
(三) 项目组其他成员情况	14
四、保荐机构与发行人之间的关联关系	14
五、保荐机构承诺事项	16
六、本次发行履行了必要的决策程序	17
(一) 董事会决策程序	17
(二) 股东大会决策程序	18
七、保荐机构关于发行人符合科创板定位的说明	20
(一) 发行人技术先进性的核查情况	20
(二) 发行人符合科创板支持方向的核查情况	25
(三) 发行人符合科创行业领域的核查情况	34
(四) 发行人符合科创属性相关指标的核查情况	35
(五) 关于发行人符合科创板定位的结论性意见	37
八、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件	37
(一) 发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的发行条件	37
(二) 发行人符合发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元的规定	43
(三) 发行人符合公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上的规定	43

（四）发行人市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求标准	43
（五）上海证券交易所规定的其他上市条件	44
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排	44
十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式	45
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项	45
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论	45

中国国际金融股份有限公司

关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的上市保荐书

上海证券交易所：

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“龙迅股份”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”“本项目”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则（2020年修订）》（以下简称“《科创板发行上市审核规则》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》和《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等有关规定，龙迅半导体（合肥）股份有限公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。）

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称	龙迅半导体（合肥）股份有限公司
英文名称	Lontium Semiconductor Corporation
注册资本	人民币 5,194.4146 万元
统一社会信用代码	913400007950924118
法定代表人	FENG CHEN
有限公司成立日期	2006 年 11 月 29 日
股份公司成立日期	2015 年 9 月 18 日
住所	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园 B3 栋
邮政编码	230601
电话	0551-68114688-8100
传真	0551-68114699
互联网网址	www.lontiumsemi.com
电子信箱	yzhao@lontium.com
负责信息披露和投资者关系的部门	投资与战略发展部
信息披露和投资者关系负责部门负责人	赵彧
信息披露和投资者关系负责部门联系电话	0551-68114688-8100

（二）发行人主营业务

公司是一家专注于高速混合信号芯片研发和销售的集成电路设计企业。公司高速混合信号芯片产品主要可分为高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片。经过长期的技术创新积累，公司已开发一系列具有自主知识产权的高速混合信号芯片产品，可全面支持 HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA 等多种信号协议，广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC 及周边、5G 及 AIoT 等多元化的终端场景。

公司高清视频桥接及处理芯片主要用于多种高清视频信号的协议转换与功能处理，公司高速信号传输芯片主要用于高速信号的传输、复制、调整、放大、分配、切换等功能。公司已开发超过 140 款的高速混合信号系列芯片产品，多款产品在性能、兼容性等

方面具备了国际竞争力。根据 CINNO Research 统计，公司在 2020 年全球高清视频桥接芯片市场中销售额居于第六位，在 2020 年全球高速信号传输芯片市场中销售额居于第八位，公司也是前述各市场中排名前二的中国大陆芯片设计企业。

公司通过持续的研发投入与技术探索，已掌握了多项国内领先或达到世界先进水平的核心技术。公司高度重视研发投入，在高速混合信号芯片领域已积累了丰富的知识产权。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已获得境内专利 68 项（其中发明专利为 54 项），境外专利 35 项（全部为发明专利），集成电路布图设计专有权 100 项，软件著作权 73 项。公司自成立以来获得了“国家鼓励的重点集成电路设计企业”、“国家重点‘小巨人’企业”、“国家专精特新中小企业”、“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”等多项荣誉与资质。

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动企业发展，通过产品的高效迭代、技术能力的持续升级构筑全方位的竞争优势。公司的技术能力与产品性能近年来正持续受到国内外知名客户的认可。公司已成功进入鸿海科技、视源股份、亿联网络、脸书、宝利通、思科、佳明等国内外知名企业供应链。同时，高通、英特尔、三星、安霸等世界领先的主芯片厂商已将公司产品纳入其部分主芯片应用的参考设计平台中。

公司将坚持深耕于高速混合信号芯片领域，以“为数字世界创新数模混合信号技术”为使命，致力于通过技术创新提供高性能的芯片解决方案。公司将通过现有产品线的持续迭代升级以及新产品线的多元化开拓，力争成为世界领先的高速混合信号芯片方案提供商。

报告期内，公司主营业务收入构成分产品构成如下：

单位：万元

产品类别	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
高清视频桥接及处理芯片	19,885.49	84.96%	10,243.70	75.46%	6,833.70	65.36%
高速信号传输芯片	3,361.52	14.36%	3,130.75	23.06%	3,417.39	32.69%
其他	159.51	0.68%	199.70	1.47%	203.68	1.95%
合计	23,406.53	100.00%	13,601.73	100.00%	10,454.77	100.00%

（三）发行人核心技术与研发水平

1、核心技术

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动企业发展，通过产品的高效迭代、技术能力的持续升级构筑全方位的竞争优势。公司自成立以来一直注重技术研发，报告期内公司研发投入分别为 3,141.51 万元、3,705.69 万元和 4,923.67 万元，占营业收入的比例为 30.05%、27.30%和 21.04%。通过持续的研发投入与技术探索，公司已掌握了高速混合信号电路及芯片集成技术、高速数据传输芯片收发电路技术、高速接口传输协议处理技术、高带宽数字内容保护技术、高清视频及音频处理技术、高速混合信号芯片量产测试技术等多项达到国内领先或世界先进的核心技术。

2、研发水平

公司在兼容性、低功耗设计、高集成度方面积累了丰富的研发技术经验，高速混合信号芯片产品功能完备，主要性能在产品所处细分领域内达到行业前沿水平。随着公司人才队伍的成长和壮大，公司正逐步开发性能和功能更先进的高速混合信号芯片，以满足未来更高端化的市场需求。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已获得境内专利 68 项（其中发明专利为 54 项），境外专利 35 项（全部为发明专利），集成电路布图设计专有权 100 项，软件著作权 73 项。公司自成立以来获得了“国家鼓励的重点集成电路设计企业”、“国家重点‘小巨人’企业”、“国家专精特新中小企业”、“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”等多项荣誉与资质。

（四）发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
资产总额（万元）	33,131.83	24,001.03	19,385.81
归属于母公司所有者权益（万元）	27,540.08	20,182.94	16,594.05
资产负债率（合并）	16.88%	15.91%	14.40%
资产负债率（母公司）	18.42%	13.21%	11.97%
营业收入（万元）	23,406.53	13,574.15	10,454.77
净利润（万元）	8,406.74	3,533.39	3,318.55
归属于母公司所有者的净利润（万元）	8,406.74	3,533.39	3,318.55
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	7,103.72	1,029.16	1,764.09

项目	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
基本每股收益（元）	1.62	0.68	0.67
稀释每股收益（元）	1.62	0.68	0.67
加权平均净资产收益率	35.90%	19.23%	26.81%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,202.52	5,609.85	4,602.92
现金分红（万元）	1,298.60	-	-
研发投入占营业收入比例	21.04%	27.30%	30.05%

（五）发行人存在的主要风险

1、技术风险

（1）技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业具有技术密集型的特征，市场需求的不断升级、产品技术的持续迭代是行业的发展重要规律。公司主营业务所在的高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片细分领域的技术与方案伴随着终端需求的变化也不断推陈出新。公司需要持续不断地推出符合技术发展方向与市场需求趋势的新产品才能维持并提升公司的竞争力。如果未来公司技术迭代创新和产品升级换代未达到预期，难以满足市场需求的最新变化，可能会使得公司在市场竞争中处于不利地位，对公司未来业务发展造成不利影响。

（2）研发失败风险

公司主营业务为高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片的研发设计与销售。公司需要结合技术发展和市场需求确定研发方向，持续进行现有产品线的升级与新产品的开发，以适应不断变化的市场需求，并持续投入大量的资金和人员进行研发。报告期内，公司研发投入分别为 3,141.51 万元、3,705.69 万元、4,923.67 万元，占营业收入的比例分别为 30.05%、27.30%、21.04%。由于新技术与产品的研发与产业化具有一定的不确定性，如果公司的研发创新方向与行业发展趋势出现较大偏离，或相关研发成果短期内无法产业化，公司将面临研发失败的风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

（3）核心技术泄密风险

经过十多年来持续的技术积累，公司储备了一系列拥有自主知识产权的核心技术。

为保护核心技术，公司制定了专门的知识产权管理制度，通过申请专利、集成电路布图设计、软件著作权等方式对核心技术进行保护。公司与核心技术人员签订了相关的保密条款和竞业限制条款，防止核心技术的外泄。但如未来因研发人员流失、关键信息泄露、核心技术保管不善等因素导致核心技术泄密，将对公司业务造成不利影响。

2、经营风险

（1）政策变化及下游应用行业波动风险

公司处于集成电路设计行业，集成电路设计行业是国家重点支持和鼓励发展的战略性新兴产业之一，国家政策的导向对行业的发展有巨大的推进作用。公司产品应用领域广泛，业务发展一定程度上也会受到国家产业政策调整和下游行业发展的影响。如果未来集成电路设计行业的产业政策发生重大不利变化，或因产品下游应用行业需求出现显著波动，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（2）市场竞争加剧风险

公司在所处细分行业主要竞争对手为境外知名集成电路设计公司，相比之下，公司在整体规模、研发实力、营销网络、客户资源、融资渠道等方面与境外龙头公司尚存在一定差距。在 2020 年全球高清视频桥接芯片市场中，德州仪器占 41.0% 的市场份额，公司当前仅占 4.2%；2020 年全球高速信号传输芯片市场份额中，德州仪器占 45.7% 的市场份额，公司当前仅占 0.9%。同时，近年来显现的市场机遇也吸引了部分国内企业进入该领域。在日趋激烈的市场竞争环境下，若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术升级、提高产品性能与服务质量，则公司的市场地位与经营业绩等可能受到不利影响。

（3）供应商集中度高风险

公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发设计和销售，生产环节主要委托晶圆生产厂和封装测试厂进行制造加工。报告期各期，公司向前五名供应商采购金额合计为 3,877.82 万元、6,015.94 万元和 9,462.46 万元，占同期采购总额的 97.15%、98.78% 和 96.19%，供应商集中度较高。未来若公司合作的主要供应商因各种原因不能如期生产交付公司，则短期内将对公司产品出货与经营业绩造成不利影响。

（4）贸易摩擦风险

报告期各期，公司境外销售收入分别为 5,266.58 万元、5,086.87 万元和 10,507.45 万元，占当期营业收入比例分别为 50.37%、37.47%和 44.89%，公司境外销售比例较高。此外，公司晶圆制造及封装测试主要自境外采购。未来如果全球贸易摩擦加剧，境外客户可能会采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相关关税等措施，境外供应商可能会被限制或禁止向公司供货，上述情况会对公司经营产生不利影响。

(5) 客户相对集中风险

报告期内，公司前五大客户的销售收入金额分别为 5,675.46 万元、5,918.49 万元和 9,177.40 万元，占营业收入比例分别为 54.29%、43.60%和 39.21%，客户集中度较高。如果未来公司主要客户的经营、采购战略产生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，将对公司经营产生不利影响。

3、内控风险

(1) 经营规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司的经营规模持续扩大，主营业务收入分别为 10,454.77 万元、13,574.15 万元和 23,406.53 万元，公司总资产分别为 19,385.81 万元、24,001.03 万元和 33,131.83 万元。随着公司业务持续发展和募投项目的实施，公司的收入和资产规模会进一步扩大，从而在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层和内部管理水平提出更高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，公司将面临较大的管理风险。

(2) 内控制度建设和执行的风险

内部控制制度是保障企业财产与会计信息的完整性、安全性以及可靠性的关键制度。出于业务发展和企业管理的需要，公司制定了符合科创板上市公司要求的内部控制体系。如果公司未来不能随着业务人员的发展而及时调整完善有关内部控制制度及体系，或者有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实，将影响企业管理的有效性，不利于维护公司财产安全并保持经营业绩的稳定增长。

4、财务风险

(1) 收入波动风险

报告期内，公司主营业务收入分别为 10,454.77 万元、13,574.15 万元和 23,406.53 万元，呈现快速增长的趋势。公司业务规模增长主要受下游需求增长、技术升级迭代等因素影响。若公司未能及时判断下游需求变化、技术实力停滞不前，或者因市场竞争格局发生变化等原因，导致公司出现产品售价下降、销售量降低等不利情形，公司收入持续增长存在不确定性风险。

(2) 毛利率波动风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 61.97%、56.56% 和 64.53%。公司产品毛利率主要受下游需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本、公司设计能力等多种因素影响，若上述因素发生不利变动，可能导致公司毛利率下降，从而影响公司盈利能力。

(3) 存货余额较大及减值风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,094.36 万元、2,897.19 万元和 4,363.61 万元，存货规模较大，占各期末总资产的比例分别为 15.96%、12.07% 和 13.17%；同期存货周转率分别为 1.12 次/年、1.69 次/年和 1.98 次/年，低于同行业上市公司。如果下游市场需求下降或晶圆等原材料价格出现大幅下跌，公司将面临大幅计提存货跌价准备的风险，导致公司经营业绩下滑，给公司生产经营和业务发展带来不利影响。

(4) 政府补助不能持续风险

报告期各期，公司获得的政府补助对利润总额的贡献分别为 1,790.06 万元、2,522.36 万元和 1,191.43 万元，占当期利润总额的比例分别为 49.93%、67.84% 和 13.55%，占比较大。公司所处行业属于政策支持行业，若未来公司承担的政府补助项目减少或未能通过相关部门审核验收，则存在政府补助不能持续或被要求退回的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

(5) 税收优惠政策变动风险

报告期内，公司作为高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业，公司 2019 年度享受 15% 的企业所得税优惠税率，2020 年度、2021 年度享受 10% 的企业所得税优惠税率。若国家相关税收优惠政策发生变化，或者公司未能持续获得高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业认定，则可能面临因税收优惠减少或取消而导致盈利能力下降的风险。

（6）汇率波动风险

公司存在境外采购和销售，并通过美元进行结算。报告期各期，公司汇兑净收益分别为 5.99 万元、-63.52 万元和-75.11 万元，对公司经营业绩影响较小。

未来若人民币与美元汇率发生大幅波动以及未来公司经营规模持续扩大后以美元计价的销售额和采购额进一步增长，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩造成不利影响。

5、法律风险

（1）知识产权相关风险

公司拥有的商标、专利等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。随着高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片及相关领域市场竞争日趋激烈，公司未来仍可能出现知识产权被第三方侵犯、知识产权涉及侵权诉讼或纠纷等情形。如果公司通过法律途径寻求保护，将为此付出额外的人力、物力及时间成本，从而导致公司商业利益受到一定程度的损失。如公司相关核心技术被竞争对手所获知并效仿，或者第三方侵犯公司知识产权的行为得不到及时防范和制止，可能对公司未来业务发展和生产经营产生负面影响。

（2）产品质量相关风险

随着公司经营规模的持续扩大，对质量控制能力的要求逐步提高，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，公司产品出现质量问题，可能导致与客户的潜在诉讼和纠纷，影响公司的市场地位和品牌声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（3）部分员工录用文件中存在“类似期权安排”相关风险

发行人创始人 FENG CHEN 在公司的发展早期曾尝试引入类似期权的安排以完善员工激励机制，为此曾在向部分员工发放的《录用通知书》和/或与部分员工签订的《劳动合同》（《录用通知书》与《劳动合同》合称“录用文件”）中记载了工作满周年后将获得一定数量期权（个别文件表述为股份、原始股）的表述（简称“类似期权安排”）。截至本上市保荐书出具之日，有两名离职员工曾就“类似期权安排”提起诉讼或劳动仲裁，但均未得到法院或劳动仲裁委的支持。若有极个别离职员工就“类似期权安排”提出相关请求且获得争议解决机构支持的，则公司存在因或有败诉而承担经济补偿的风险。

6、新冠疫情导致的风险

2020 年新冠肺炎疫情爆发并席卷全球。为了有效控制疫情，各国采取保持社交距离、停工停产等管控措施，对行业的正常运转造成了不利影响。全球新冠疫情仍在持续，我国新型冠状病毒肺炎防控也依然面临复杂考验，新冠疫情的反弹可能会对公司产业链及客户需求带来冲击，从而导致公司存在不能正常实施生产计划和销售计划的风险。

7、与募集资金投资项目相关风险

由于本次募集资金投资项目的投资金额较大，募集资金投资项目的实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求，公司需要进一步补充研发、运营和管理团队，提高人力资源、法律、财务等方面的管理能力，做好项目管理和组织实施工作，保证募投项目按照计划顺利完成。但募集资金投资项目时间跨度较长，若公司未能及时、可靠的处理项目投资建设期间出现的管理和实施风险，将可能导致募投项目不能如期完成，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

8、本次发行失败的风险

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的要求，若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应当中止，若发行人公司中止发行上市审核程序超过上交所规定的时限或者中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，或将会出现发行失败的风险。

二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 1,731.4716 万股 （行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 25.00%
其中：发行新股数量	不超过 1,731.4716 万股 （行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 25.00%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	无
发行后总股本	不超过 6,925.8862 万股（行使超额配售选择权之前）		
每股发行价格	人民币【】元		

发行市盈率	【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	【】元（按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元（按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用向网下投资者配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销方式		
拟公开发售股份股东名称	本次发行不涉及公司原有股东向投资者公开发售		
发行费用的分摊原则	本次发行不涉及公司原有股东向投资者公开发售，不涉及发行费用分摊，发行费用全部由发行人承担		
募集资金总额	募集资金总额【】元		
募集资金净额	扣除新股发行费用后，募集资金净额【】元		
募集资金投资项目	(1) 高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目 (2) 高速信号传输芯片开发和产业化项目 (3) 研发中心升级项目 (4) 发展与科技储备资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，其中： (1) 承销费及保荐费【】万元 (2) 审计费【】万元 (3) 律师费【】万元 (4) 发行手续费【】万元 (5) 其他【】万元		

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

魏先勇：于 2014 年取得保荐代表人资格，曾经担任华润微电子有限公司（688396）向特定对象发行 A 股股票项目、中芯国际集成电路制造有限公司（688981）首次公开发行股票并在科创板上市项目、华润微电子有限公司（688396）首次公开发行股票并在科创板上市项目、中远海运控股股份有限公司（601919）非公开发行项目的保荐代表人，

在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

占海伟：于 2021 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

项目协办人：刘剑峰，于 2011 年取得证券从业资格，曾经参与/执行宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997）首次公开发行股票并在科创板上市项目、江苏日久光电股份有限公司（003015）首次公开发行股票并在深交所主板 A 股上市项目、杭州美迪凯光电科技股份有限公司（688079）首次公开发行股票并在科创板上市项目。

（三）项目组其他成员情况

项目组其他成员：吴迪、徐放、方清、袁赵苑、陆偲绩

四、保荐机构与发行人之间的关联关系

1、本机构自身及本机构下属子公司持有或通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况：

截至本上市保荐书出具之日，持有发行人 6.78% 股份的红土创投和持有发行人 4.00% 股份的华富瑞兴经过逐层追溯后的间接出资人中包含中金公司相关主体，中金公司相关主体通过上述持股路径间接持有发行人的股份比例极低，合计间接持有发行人的股份不足 0.01%。除上述情形外，本机构自身及本机构下属子公司不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

中金公司作为龙迅股份本次首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，严格遵守相关法律法规及监管要求，切实执行内部信息隔离制度，充分保障保荐机构的职业操守和独立性。中金公司建立并实施包括《限制名单政策》在内的信息隔离墙制度，在制度上确保各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的妥善管理，以防范内幕交易及避免因利益冲突产生的违法违规行为。通过上述路径间接持有发行人股份的中金公司相关主体的对外投资依据其独立投资研究决策或者根据相关法律法规执行的投资，与本次保荐项目并无关联。

截至本上市保荐书出具之日，中金公司通过前述的持股路径间接持有发行人股份的情形不影响保荐机构履行保荐职责的独立性，保荐机构与发行人之间不存在利益冲突。中金公司担任发行人保荐机构符合《证券发行上市保荐业务管理办法》关于保荐机构独立性的要求。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律、法规的规定，发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司，参与本次发行战略配售，并对获配股份设定限售期，具体认购数量、金额等内容在发行前确定并公告。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本机构及本机构下属子公司股份的情况。

3、本机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

4、中金公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），截至本上市保荐书出具之日，中央汇金直接持有中金公司约 40.11% 的股权，同时，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司各持有中金公司约 0.06% 的股权。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。根据发行人提供的资料及公开信息资料显示，中金公司上级股东单位与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互持股的情况，中金公司上级股东单位与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或融资的情况。

5、本机构与发行人之间不存在其他关联关系。

本机构依据相关法律法规和公司章程，独立公正地履行保荐职责。

五、保荐机构承诺事项

（一）中金公司承诺已按照法律法规和中国证监会、上交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

（二）作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司本次发行的保荐机构，本机构：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规、中国证监会以及上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会、上交所依照相关法律、行政法规采取的监管措施。

（三）中金公司承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

（四）中金公司承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

六、本次发行履行了必要的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》、上海证券交易所及中国证监会规定的决策程序，具体如下：

（一）董事会决策程序

2022年2月28日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目及可行性研究报告的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》《关于制订〈龙迅半导体（合肥）股份有限公司未来三年分红回报规划（2022-2024年）〉的议案》《关于制定〈龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程（草案）〉的议案》《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》等，就本次股票发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，并提请发行人2022年第一次临时股东大会审议。决议内容如下：

（1）发行的具体方案

1) 发行股票的种类和面值：人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1.00元；

2) 发行股数：以公司现行总股本5,194.4146万股为基数，本次拟公开发行人民币普通股不超过1,731.4716万股，不低于发行后股份总数的25%。若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发行股票的发行数量将进行相应的调整。公司发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；

3) 定价方式：向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价，发行人和主承销商通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格；

4) 发行方式：采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行或中国证监会、上海证券交易所认可的其他发行方式进行；

5) 发行对象：符合资格的询价对象、战略投资者、在上海证券交易所开户且符合资格的科创板市场投资者，或中国证监会、上海证券交易所认可的其他投资者，中国法律、法规、规章及规范性文件禁止购买者除外；

6) 拟上市地：上海证券交易所科创板；

7) 承销方式：由中国国际金融股份有限公司以余额包销方式承销；

8) 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(2) 本次募集资金使用的可行性

根据公司实际经营情况，公司拟定了本次公开发行股票募集资金使用项目的可行性研究报告。募集资金使用项目如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目	28,167.06	25,745.06
高速信号传输芯片开发和产业化项目	17,664.32	16,502.32
研发中心升级项目	34,667.69	33,547.69
发展与科技储备资金	20,000.00	20,000.00
合计	100,499.07	95,795.07

(二) 股东大会决策程序

2022 年 3 月 15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目及可行性研究报告的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》《关于制订<龙迅半导体（合肥）股份有限公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）>的议案》《关于制定<龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于公司上市后稳定公司股价的预案的议案》《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》等与本次发行上市相关的议案，就本次发行的股票种类和面值、数量、发行对象、发行方式、定价方式、股票上市地点、募集资金用途、本次发行前滚存利润的分配方案、《公司章程（草案）》、决议的有效期及对

董事会办理本次发行具体事宜的授权等事项进行了表决，并批准了本次发行，决议内容如下：

1) 发行股票的种类和面值：人民币普通股股票（A 股），每股面值人民币 1.00 元；

2) 发行对象：符合资格的询价对象、战略投资者、在上海证券交易所开户且符合资格的科创板市场投资者，或中国证监会、上海证券交易所认可的其他投资者，中国法律、法规、规章及规范性文件禁止购买者除外；

3) 定价方式：向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价，发行人和主承销商通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格；

4) 募集资金的用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目	28,167.06	25,745.06
2	高速信号传输芯片开发和产业化项目	17,664.32	16,502.32
3	研发中心升级项目	34,667.69	33,547.69
4	发展与科技储备资金	20,000.00	20,000.00
合计		100,499.07	95,795.07

5) 发行前滚存利润的分配方案：如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）获得核准，并且发行成功，则本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。

6) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；

7) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权：

①根据适用的法律法规，制作、修改、签署、申报本次发行及上市涉及的申请材料；

②授权董事长或总经理代表公司签署本次发行及上市过程中涉及的公司、协议、及有关需以公司名义出具的法律文件；

③根据证券监管机构的要求和证券市场的实际情况，最终确定和实施本次发行及上市的具体方案，包括但不限于发行价格、发行数量、发行方式、超额配售选择权等事项；

④在本次发行前按照《龙迅半导体（合肥）股份有限公司募集资金管理制度》开设募集资金专用账户；

⑤在股东大会审议通过的募集资金投资项目的总投资额范围内，具体决定各项目的投资方案；

⑥根据本次发行及上市的具体情况修改公司章程及内部管理制度等相关条款；

⑦在本次发行及上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股票登记结算相关事宜，包括但不限于股票托管登记、限售流通股锁定等事宜；

⑧办理与本次发行及上市有关的其他事宜。

综上，保荐机构认为，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》以及中国证监会和上交所规定的决策程序。

七、保荐机构关于发行人符合科创板定位的说明

本机构根据中国证监会颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创属性评价指引（试行）》以及上交所颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等有关规定对发行人是否符合科创板的定位要求进行核查分析。

经核查分析，本机构认为，发行人符合科创板的定位要求，具体情况如下：

（一）发行人技术先进性的核查情况

1、公司的技术先进性及其表征

公司通过持续的研发投入与技术探索，已掌握了多项国内领先或达到世界先进水平的核心技术。公司高度重视研发投入，在高速混合信号芯片领域已积累了丰富的知识产权。依托核心技术，公司已开发超过 140 款的系列芯片产品，多款产品在性能、兼容性等方面具备了较强的国际竞争力。

公司高清视频桥接及处理芯片主要是对各种高清视频信号进行协议转换及功能处理，使得高清视频信号经桥接及处理后可以满足不同设备的使用需求。随着视频会议、人工智能、自动驾驶、AR/VR 等下游技术革命带来高清视频显示场景的不断增加，对分辨率要求的不断提升，以及高清视频信号协议标准的不断升级，市场对于高清视频桥接及处理芯片的需求也不断上升。公司高清视频桥接及处理芯片可兼容各主流视频信号协议的转换，同时具有丰富的视频处理功能。

公司高速信号传输芯片用于信号的有线传输，能实现信号的高速传输、复制、调整、放大、分配、切换等功能。随着物联网、云计算、人工智能、5G 通讯、无人驾驶等数字新兴产业的涌现与发展，数据传输量呈现指数级上升趋势，各类高速传输协议标准不断更新升级，进而终端应用对于高速信号传输芯片解决方案的需求也不断攀升。公司高速信号传输芯片可支持各类视频协议信号及 5G 通讯信号的传输和交换。公司将视觉无损压缩技术与 HDMI2.0 协议相结合，形成了独有的高性能、低功耗超高清视频远距离传输解决方案。公司高速信号传输芯片具有低功耗、低延迟、高带宽、高可靠性等特点。

基于领先的技术能力与优质的产品性能，公司已成功进入鸿海科技、视源股份、亿联网络、脸书、宝利通、思科、佳明等国内外知名企业供应链。同时，高通、英特尔、三星、安霸等世界领先的主芯片厂商已将公司产品纳入其部分主芯片应用的参考设计平台中。公司自成立以来获得了“国家鼓励的重点集成电路设计企业”、“国家重点‘小巨人’企业”、“国家专精特新中小企业”、“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”等多项荣誉与资质。具体来说，公司与各主营业务密切相关的主要核心技术及其先进性如下表所示：

(1) 公司的核心技术

序号	核心技术名称	来源	技术所处阶段	技术先进性及表征	对业务的作用和贡献	技术先进程度
1	高速混合信号电路及芯片集成技术	自主研发	产业化	通过数模电源隔离设计、防静电通路设计、数模接口全局设计、定制化 full-chip（全芯片模拟）集成流程、搭建数模混合仿真环境等技术，解决在标准 CMOS 工艺上设计高速高精度模拟电路和全芯片集成的技术难点，积累了多通道高速时钟同步、音视频时钟恢复、数模电源域信号处理等技术功能	是公司数模混合芯片产品集成、量产的重要技术，对芯片的性能、可靠性提供技术支撑，能够保障公司产品的良率维持在较高水平	国内领先
2	高速数据传输芯片收发电路技术	自主研发	产业化	采用了多级预加重技术增强了发射端的信号，相应在接收端采用了自适应信号增益均衡控制技术、数据时钟恢复技术、时钟相位插值器技术，解决了在有线传输通信中的高速信号衰减补偿以及时钟数据恢复的技术难点，在收发系统中均使用了高性能锁相环电路技术、自动温度检测补偿技术、高精度基准源、定制化串并互转电路技术等	是公司数模混合芯片产品的核心模块，是公司芯片产品速度、功耗、可靠性等主要性能实现的重要保证	国内领先
3	高速接口传输协议处理技术	自主研发	产业化	包括高清视频行业主流的视频协议模块设计以及其他主流数据传输、电源管理等协议模块设计，支持先进的 HDMI2.1、DP1.4、MIPI1.2 等协议，支持 USB2.0/3.0、PD3.0 协议，可支持 8K 视频分辨率、同步、VRR、DSC1.2a 视觉无损编解码、FEC 纠错、多路视频传输 MST、高动态范围 HDR、ARC/eARC 声音回传等功能；该技术还实现了多个视频协议的融合集成，在降低芯片面积和功耗的基础上，实现了多协议兼容	该项技术是公司重要核心模块之一，是公司可以支持多款协议的技术体现，是公司产品多样性的必要技术	达到国际先进水平
4	高带宽数字内容保护技术	自主研发	产业化	通过对 HDCP 数据加解密算法的深入分析和架构实现优化，降低了对时序和功能模块的要求，实现多格式、多版本的良好兼容。该技术用较少的面积和功耗成本，用硬件的方式实现数据流媒体的信息保护，防止数据流在线上被恶意监听和复制	该项技术解决了多版本、多协议的硬件加解密方式对硬件资源需求高的技术难点，实现功能、兼容性、面积、功耗的优化，有助于降低设计成本、提升良率。该技术用于公司 HDMI、DP 类产品，实现对多媒体内容的保护	达到国际先进水平
5	高清视频及音频处理技术	自主研发	产业化	通过自主研发的视频处理算法、LPDDR4 控制器技术，实现了对 4K 超高清视频数据的无损压缩与解压缩（DSC）、缩放、旋转、梯形矫正、视频分割、帧率转换、色彩空间处理、亮度处理、高动态范	该项技术包含多个核心功能模块，是公司 4K 视频处理芯片的核心模块，为公司前沿的 4K/8K 视频处理相关	国内先进

序号	核心技术名称	来源	技术所处阶段	技术先进性及表征	对业务的作用和贡献	技术先进程度
				围图像处理（HDR）、3D 画面分割、多路视频处理（MST）、OSD 等视频处理功能；在音频方面，实现对音频数据接收、发送，音频时钟的恢复，音频解析、声画同步、采样率转换、声音回传（ARC/eARC）等处理功能	芯片的性能提供重要的技术支持与进一步开发基础，有较强的核心竞争力	
6	高速混合信号芯片量产测试技术	自主研发	产业化	该系列技术采用 loop-back、ATPG Pattern、MBIST、ABIST、内建功能测试 Pattern 以及 Pattern 自动检测等自测试方法以及 FPGA/ASIC 芯片高速信号生成和硬件错误检测的自动化测试技术方案，单通道高速信号测试速度可达 12.5Gbps，解决高速芯片测试时所遇到的一致性筛选问题，降低了高成本测试设备的使用时间，提高了生产效率，减少方案开发和测试时间，降低测试成本	该项技术可降低对高端测试设备的依赖，可以较大程度缩短测试开发周期，减少测试时间，提高公司芯片产品的测试覆盖率和良率，节约测试成本	国内领先

（2）专利、集成电路布图设计所有权、软件著作权情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已获得境内专利 68 项（其中发明专利为 54 项），境外专利 35 项（全部为发明专利），集成电路布图设计专有权 100 项，软件著作权 73 项。

（3）主要专业资质、获奖情况

报告期内，公司主要获奖情况如下：

序号	公司	荣誉名称	颁布单位	获得时间
1	发行人	国家重点鼓励发展的集成电路设计企业	国家发展改革委、工信部、财政部、海关总署、税务总局	2021 年
2	发行人	国家重点“小巨人”企业	工信部	2021 年
3	发行人	国家专精特新中小企业	工信部	2021 年
4	发行人	国家知识产权优势企业	国家知识产权局	2019 年
5	发行人	高新技术企业	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局	2020 年
6	发行人	安徽省工业设计中心	安徽省经信厅	2021 年
7	发行人	安徽省专利奖优秀奖	安徽省市场监督管理局	2021 年
8	发行人	安徽省专利奖银奖	安徽省市场监督管理局	2020 年
9	发行人	安徽省企业技术中心	安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局、中国人民共和国合肥海关	2019 年
10	朗田亩	高新技术企业	深圳市科技创新委员会、深圳市财政会、国家税务总局深圳市税务局	2020 年

2、核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

（1）访谈了发行人相关研发人员，了解发行人研发的技术及其功能性能、取得的研发进展及其成果；

（2）查阅了行业研究报告，了解行业技术的整体情况，以及发行人研发能力和技术水平在行业中的具体地位；

（3）查阅了发行人取得的专利情况，了解核心技术与专利的对应情况；

(4) 查阅了发行人获得的主要奖项等情况的证明文件，并在相关专业网站上对发行人的主要奖项进行复核。

3、核查意见

经核查，保荐机构认为：

发行人在其业务领域拥有独特的专有技术和研发能力，核心技术与产品性能先进，取得的研发进展及其成果、获得的主要专业资质和奖项真实、准确。

(二) 发行人符合科创板支持方向的核查情况

1、公司符合科创板支持方向及其依据情况

(1) 国家科技创新战略相关要求

公司主营业务为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发设计和销售。经过长期的技术创新积累，公司已开发一系列具有自主知识产权的高速混合信号芯片产品，可全面支持 HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA 等多种信号协议，广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC 及周边、5G 及 AIoT 等多元化的终端场景。

根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，集成电路芯片设计及服务是国家重点发展的战略性新兴产业之一，是《国家信息化发展战略纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的重点战略支持产业方向。

(2) 核心技术产品收入占营业收入比例

集成电路设计行业具有技术密集型特点。公司高度重视研究成果，不断通过申请专利和集成电路布图设计或制定严格的保密程序对技术予以保护。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已获得境内专利 68 项（其中发明专利为 54 项），境外专利 35 项（全部为发明专利），集成电路布图设计专有权 100 项，软件著作权 73 项。报告期内，公司累计研发投入为 11,770.87 万元，占最近三年累计营业收入比例为 24.81%。

依托上述核心技术，公司已开发超过 140 款的高速混合信号芯片产品，涵盖多款产品，包括 HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA 等多种信号协议，产品结构丰富全面，在性能、兼容性等方面具备了国际竞争力。

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动企业发展，通过产品的高效迭代、技术能力的持续升级构筑全方位的竞争优势。公司的技术能力与产品性能近年来正持续受到国内外知名客户的认可。公司已成功进入鸿海科技、视源股份、亿联网络、脸书、宝利通、思科、佳明等国内外知名企业供应链。同时，高通、英特尔、三星、安霸等世界领先的主芯片厂商已将公司产品纳入其部分主芯片应用的参考设计平台中。

报告期内，公司核心技术所实现的业务收入占营业收入的比例情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
核心技术产品收入	23,247.02	13,374.45	10,251.09
营业收入	23,406.53	13,574.15	10,454.77
核心技术产品收入占营业收入比例	99.32%	98.53%	98.05%

（3）发行人产品或服务的市场地位

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动企业发展，通过产品的高效迭代、技术能力的持续升级构筑全方位的竞争优势。公司的技术能力与产品性能正不断受到知名客户的广泛认可。

根据 CINNO Research 统计，2020 年公司占全球高清视频桥接芯片市场 4.2% 的份额，排名居于第六位，在中国大陆公司中排名第一。在中国大陆高清视频桥接芯片市场中，公司占比 6.2%，排名居于第五位。

2020 年全球高清视频桥接芯片市场份额

序号	公司名称	总部所在地	销售额 (百万元人民币)	市场份额占比
1	德州仪器	美国	917.5	41.0%
2	东芝	日本	364.8	16.3%
3	联阳	中国台湾	185.7	8.3%
4	亚德诺	美国	138.7	6.2%
5	谱瑞	美国	100.7	4.5%
6	发行人	中国大陆	94.6	4.2%
7	硅谷数模	中国大陆	69.4	3.1%
8	瑞昱	中国台湾	64.9	2.9%
9	其他	-	301.5	13.5%

序号	公司名称	总部所在地	销售额 (百万元人民币)	市场份额占比
合计			2,237.9	100.0%

数据来源：CINNO Research，发行人销售额根据经审计后公司主营业务产品分类下“高清视频桥接及处理芯片”中“视频桥接芯片”的销售收入调整

2020年中国大陆高清视频桥接芯片市场份额

序号	公司名称	总部所在地	销售额 (百万元人民币)	市场份额占比
1	德州仪器	美国	441.6	50.1%
2	谱瑞	美国	65.2	7.4%
3	东芝	日本	59.9	6.8%
4	亚德诺	美国	58.2	6.6%
5	发行人	中国大陆	54.9	6.2%
6	硅谷数模	中国大陆	34.4	3.9%
7	安格	中国台湾	32.6	3.7%
8	联阳	中国台湾	24.7	2.8%
9	其他	-	109.9	12.5%
合计			881.4	100.0%

数据来源：CINNO Research，发行人销售额根据经审计后公司主营业务产品分类下“高清视频桥接及处理芯片”中“视频桥接芯片”的销售收入调整

根据 CINNO Research 统计，2020 年公司占全球高速信号传输芯片市场 0.9% 的份额，排名居于第八位，在中国大陆公司中排名第二。在中国大陆高速信号传输芯片市场中，公司占比 3.3%，排名居于第六位。

2020年全球高速信号传输芯片市场份额

序号	公司名称	总部所在地	销售额 (百万元人民币)	市场份额占比
1	德州仪器	美国	1,560.4	45.7%
2	谱瑞	美国	898.0	26.3%
3	亚德诺	美国	324.4	9.5%
4	联阳	中国台湾	225.4	6.6%
5	硅谷数模	中国大陆	75.1	2.2%
6	瑞昱	中国台湾	44.4	1.3%

序号	公司名称	总部所在地	销售额 (百万元人民币)	市场份额占比
7	安格	中国台湾	37.6	1.1%
8	发行人	中国大陆	31.3	0.9%
9	其他	-	218.0	6.4%
合计			3,414.4	100.0%

数据来源：CINNO Research，发行人销售额根据经审计后公司主营业务产品分类下“高速信号传输芯片”的销售收入（面向5G信号传输的LT1258产品销售收入未计算在内）调整

2020年中国大陆高速信号传输芯片市场份额

序号	公司名称	总部所在地	销售额 (百万元人民币)	市场份额占比
1	德州仪器	美国	294.7	39.3%
2	谱瑞	美国	231.7	30.9%
3	亚德诺	美国	53.2	7.1%
4	联阳	中国台湾	37.5	5.0%
5	硅谷数模	中国大陆	25.5	3.4%
6	发行人	中国大陆	24.5	3.3%
7	安格	中国台湾	21.7	2.9%
8	瑞昱	中国台湾	9.7	1.3%
9	其他	-	51.3	6.8%
合计			749.9	100.00%

数据来源：CINNO Research，发行人销售额根据经审计后公司主营业务产品分类下“高速信号传输芯片”的销售收入（面向5G信号传输的LT1258产品销售收入未计算在内）调整

(4) 技术储备及技术创新的安排

1) 技术创新机制及安排

公司自创立以来坚持创新驱动发展，高度重视技术创新工作，以向市场和客户持续提供具有竞争力的产品及解决方案为目标，持续提高公司的创新能力。

①以市场和客户需求为导向的创新机制

公司坚持创新应服务于市场需求，建立了以客户需求变化和未来市场趋势为导向的研发模式。公司高度重视当前市场和客户的技术需求，在项目立项前深入市场进行调研，

并广泛收集客户需求，充分论证项目方案，形成项目的开发思路和产品升级的方案。同时，公司注重跟踪市场的发展趋势，通过前瞻性研究，完成新技术的研究和新产品的定义，保持公司技术的先进性。

②完善的项目研发和项目管理体系

公司注重研发项目的管理工作，坚持以研发项目为单位进行科学管理，并执行严谨周密的项目管理体系，保障技术创新工作的持续规范。每个项目均需经过项目立项、芯片设计、样品试产和验证阶段、试量产阶段等多个环节，每个环节严格管理，从而保障项目的有序开展。

③合理有效的考核和激励机制

公司建立了科学的绩效考核与激励机制，激发研发人员的创新思维和主观能动性，鼓励研发人员积极主动创新。通过将创新成果作为研发人员绩效考核的重要指标，对创新性强的研发成果进行奖励，调动研发人员创新的主动性。另外，公司通过股权激励的方式，将员工的个人利益与公司长期发展相结合，增强员工的归属感和责任感。同时，公司鼓励员工进行各种职务发明和创造，对知识产权申请者或者重大创新贡献者给予奖励，能很好的调动员工创新的积极性。

④规范的知识产权管理机制

公司高度重视知识产权管理工作，通过制定专门的知识产权管理制度，设立专门的管理人员，并配合规范的管理流程，对公司专利、集成电路布图登记、软件著作权、商标等知识产权进行申请与管理工作，从而全面保障公司的技术竞争力。目前，公司在知识产权管理工作方面初现成果，已荣获“国家知识产权优势企业”、“合肥市知识产权示范企业”、“合肥市知识产权管理规范企业”等荣誉。

⑤科学的人才培养机制

人才是公司发展的动力源泉，公司高度重视人才引进、培养和研发团队的建设。一方面，公司通过校园招聘、社会招聘等方式不断引进人才，逐步壮大研发团队；另一方面，公司根据业务需要定期或不定期的举行学习和培训，同时鼓励员工积极参与行业主管部门、行业协会等机构举办的培训与活动，提升自身的业务水平。

2) 技术储备

截至本上市保荐书出具之日，公司正在从事的研发项目及其进展情况如下：

序号	项目名称	项目介绍	研发目标	项目进展情况	技术来源
1	车载摄像头延长芯片的开发及应用	本项目主要研发车载 Serializer/Deserializer 延长测试芯片，为车内长距离视频传输及通信提供解决方案，应用场景包括摄像头与主控端、主控端与显示端的视频传输。Serializer 支持 TLL/MIPI/LVDS 输入，通常位于视频源端；Deserializer 支持 TTL/LVDS/MIPI/eDP 输出，通常位于视频接收端。在 MIPI 应用中，一个 Deserializer 最多可接入四个 Serializer，完成四路视频的同步传输	基于一根同轴线或者双绞线，实现单向视频传输和双向通信功能，最长距离为 15 米，单通道最高速率为 5.4Gbps，最大分辨率支持 2K@60Hz	芯片测试验证阶段	自主研发
2	带 USB3.0 开关的 Type-C/DP1.4toHDMI2.0 的转换器芯片组的开发及应用	本项目主要研发 Type-C/DP1.4 到 HDMI2.0 接口信号转换的芯片组。芯片组支持 USB3.0 信号开关切换及 PD3.0 电源传输管理，主要应用于系统主板、Type-C 相关电子配件及接口扩展等	满足 DP1.4、HDMI2.0、PD3.0 协议及 HDCP 加密和解密功能，支持单通道最大 8.1Gbps 数据传输速率，支持音频输入和输出	芯片试产阶段	自主研发
3	带音频的 HDMI2.0 转双端口 MIPI DSI/CSI 芯片的开发及应用	本项目主要研发实现 HDMI2.0 的接口信号转换为 MIPI 接口信号的芯片。芯片支持的最高分辨率为 4K@60Hz，且同时支持数字音频信号 I2S/SPDIF 的输出和 HDCP2.3 的数据解密，广泛应用于多媒体系统、视频会议系统、AR/VR 等	接收端 HDMI 支持最高数据速率为 6Gbps，MIPI 发送端每个数据通道最高支持 2.5Gbps 数据速率，可最多支持 8 个数据通道	芯片测试验证阶段	自主研发
4	MIPI/TTL/2-Port LVDS to MIPI/TTL/2-Port LVDS 转换器芯片的开发及应用	本项目主要研发支持 MIPI/LVDS/TTL 三种协议的高速 RX/TX 协议接口芯片。该芯片最高分辨率为 4K30Hz，RX/TX 可灵活配置，能够满足三种协议的所有需求。同时，接口的复用可以降低成本且保证芯片功能的多样性，主要应用于车载显示系统、转接器等	支持 6.25M-300M 像素时钟，支持 MIPI/LVDS/TTL 三种协议的相互转换，MIPI 模式最高可支持单通道 2.5Gbps，可实现一分二、二选一的功能	芯片已流片，待测试验证	自主研发
5	16X16 Digital Crosspoint Switch (数字交叉开关) 芯片的开发及应用	本项目主要研发可以实现 16 路差分输入信号向 16 路输出端口任意切换的 16X16 数字交叉开关芯片。该芯片最高支持 6Gbps 速率，内置均衡器可以补偿由于传输链路对输入信号造成的衰减，提高输出端信号质量，主要应用于多媒体信号的控制、管理、整合、切换、调度等	支持 16 路最高速率 6Gbps 的差分输入数据的任意切换，输入端可以补偿 40 英寸 FR4 背板走线对输入信号造成的衰减，输出端去加重支持最大 9.5dB 强度，可对	芯片已流片，待测试验证	自主研发

序号	项目名称	项目介绍	研发目标	项目进展情况	技术来源
			原始输入信号质量起到明显提升作用		
6	基于 4K 的高清显示控制器芯片的开发及应用	本项目主要研发可支持 4K 超高清分辨率的显示控制器的 SoC 芯片。该芯片集成了图像解压缩、电源管理、3D 图像处理、亮度处理、帧率转换、音频处理等功能，支持 OSD，支持高动态范围图像技术（HDR），支持 VRR 及 adaptive-sync，为显示器提供更逼真的视频图像效果，主要应用于多屏显示、AR/VR、超高清显示器、安防监控以及智能终端系统等	支持 DP1.4 协议，实现单通道最高 8.1Gbps 速率；支持 HDMI2.1 协议，视频分辨率最高支持 4K@144Hz；支持视觉无损压缩技术（DSC）、3D 图像处理、电源管理等功能；支持 8-lane eDP 输出和 4-port LVDS 输出	芯片设计阶段	自主研发
7	超高清音视频接口处理和转换芯片组的开发及应用	本项目主要研发超高清音视频接口的转换芯片。支持 HDMI2.1 到 DP1.4/Type-C 的转换、支持 HDMI2.1 到 4-port MIPI/LVDS 的转换，同时输出音频。支持 DP1.4/Type-C 到 HDMI2.1 的转换、支持 DP1.4/Type-C 到 4-port MIPI/LVDS 的转换，同时输出音频。支持 DSC 技术，主要应用于 HDMI2.1/DP1.4/Type-C 信号延长、AR/VR、视频桥接等	支持 HDMI2.1 协议，实现单通道 12Gbps 速率；支持 DP1.4 协议，实现单通道最高 8.1Gbps 速率；支持 MIPI C-PHY 协议，单通道最高 5.7Gbps 速率；支持 MIPI D-PHY 协议，单通道最高 2.5Gbps 速率；支持 LVDS 协议，单通道最高 1.2Gbps 速率。视频分辨率最高支持 4K@144Hz，音频采样率最高支持 192KHz	芯片设计阶段	自主研发
8	Type-C/DP 转 HDMI/VGA 芯片工程开发	本项目主要对 USB Type-C/DP 转 HDMI/VGA 芯片进行工程开发，包括功能和性能优化、FT 测试方案开发、可靠性测试、参考方案开发等。该芯片支持 HDCP 和 MST，内置微处理器，能够自动控制，芯片控制也可通过 I2C 接口实现，主要应用于扩展坞、视频多端口转换器、适配器等	完成 FT 测试方案开发；完成可靠性测试；完成参考方案开发	参考方案开发阶段	自主研发
9	USB2.0 高速信号调节器芯片工程开发	本项目主要对 USB 2.0 高速信号调节器芯片进行工程开发，包括功能和性能优化、FT 测试方案开发、可靠性测试、参考方案开发等。该芯片用于补偿高速信号衰减，无需打断 DP/DM 走线即可无风险设计完整的 USB 通道，主要应用于 PC、手提电脑主机板、移动手机、背板、电缆延长器、电视等	完成 FT 测试方案开发；完成可靠性测试；完成参考方案开发	参考方案开发阶段	自主研发

序号	项目名称	项目介绍	研发目标	项目进展情况	技术来源
10	HDMI2.0 延长芯片组工程开发	本项目主要对 HDMI2.0 延长芯片组进行工程开发，包括功能和性能优化、FT 测试方案开发、可靠性测试、参考方案开发等。该芯片组包括 HDMI 发送芯片和 HDMI 接收芯片，可实现信号延长。该芯片内置微处理器，能够自动控制，也可通过 I2C 接口实现芯片控制，主要应用于可移动系统、显示器、VR、有源电缆、监视器、KVM 拓展等	完成 FT 测试方案开发；完成可靠性测试；完成参考方案开发	参考方案开发阶段	自主研发
11	Type-C 转 HDMI2.0 和 VGA 芯片工程开发	本项目主要对 Type-C 转 HDMI2.0/VGA 芯片进行工程开发，包括功能和性能优化、FT 测试方案开发、可靠性测试、参考方案开发等。该芯片内置微处理器，能够自动控制，芯片控制也可通过 I2C 接口实现，主要应用于中低端扩展坞、适配器等	完成 FT 测试方案开发；完成可靠性测试；完成参考方案开发	参考方案开发阶段	自主研发
12	HDMI/DP 接收芯片工程开发	本项目主要对 HDMI/DP 接收芯片进行工程开发，包括功能和性能优化、FT 测试方案开发、可靠性测试、参考方案开发等。该芯片可以接收 HDMI 或 DP 双模信号输入，转换成 LVDS 或 MIPI 双模信号输出，支持 2D 和 3D 场景显示，内置微处理器，能够自动控制，并通过 I2C 接口实现芯片控制，主要应用于 AR/VR、视频会议系统等	完成 FT 测试方案开发；完成可靠性测试；完成参考方案开发	参考方案开发阶段	自主研发
13	USB Type-C/DP1.4 转 HDMI2.1/MIPI 芯片工程开发	本项目主要对 USB Type-C/DP1.4 转 HDMI2.1/MIPI 芯片进行工程开发，包括功能和性能优化、FT 测试方案开发、可靠性测试、参考方案开发等。该芯片内置微处理器，能够自动控制，芯片控制也可通过 I2C 接口实现，主要应用于多屏显示、AR/VR、超高清显示器、安防监控以及智能终端系统等	完成 FT 测试方案开发；完成可靠性测试；完成参考方案开发	可靠性测试阶段	自主研发
14	12.5Gbps 讯号中继器芯片工程开发	本项目主要对 12.5Gbps 讯号中继器芯片进行工程开发，包括功能和性能优化、FT 测试方案开发、可靠性测试、参考方案开发等。该芯片用于重新产生信号、在高速接口上增强信号质量，产品应用范围广泛，包括通信高速背板、基站、光传输网、Data 通讯等应用	完成 FT 测试方案开发；完成可靠性测试；完成参考方案开发	FT 测试方案开发阶段	自主研发
15	HDMI2.0 Matrix/Splitter 芯片工程开发	本项目主要对 HDMI2.0 Matrix/Splitter 芯片进行工程开发，包括功能和性能优化、FT 测试方案开发、可靠性测试、参考方案开发等。该芯片内置微处理器，能够自动控制，芯片	完成 FT 测试方案开发；完成可靠性测试；完成参考方案开发	FT 测试方案开发阶段	自主研发

序号	项目名称	项目介绍	研发目标	项目进展情况	技术来源
		控制也可通过 I2C 接口实现，主要应用于显示器、投影仪、A/V 功放接收器等			
16	基于 HDMI2.1 转 DP1.4 8K 转换方案开发	本项目主要研发 HDMI2.1 转 DP1.4 方案，主要包括 HDMI2.1 RX 8G 数据恢复、HDCP 处理(解密加密或者中继模式)、音频时钟恢复、CEC 控制、DP1.4 TX 音视频数据处理、AUX 控制器、CC 控制器和 MUX 选择器(Type-C 输出需要)、FEC 的处理、DSC 的解码和编码、EDID 分析处理	开发单芯片 HDMI2.1 RX 转 DP1.4，支持 Type-C PD 功能的应用方案，使用内置 USB3.1 MUX，完成兼容性等相关测试，完成发布参考设计原理图和相关固件	方案设计阶段	自主研发
17	基于 HDMI2.0 4K60 网线延长方案开发	本项目主要研发 HDMI2.0 4K60 网线延长方案，主要包括 HDMI2.0 RX 的 HDCP 解密、音频时钟恢复、HDMI2.0 TX HDCP 加密、CSC 色彩空间转换、DSC 的解码和编码处理、FEC 的处理、EDID 分析及回传、红外数据的回传。该方案应用于电竞显示、智慧教育、大屏会议系统以及影院等播放及显示设备等	开发单芯片集成 HDMI2.0 RX/TX 功能的 HDMI2.0 信号延长方案，支持自动增益控制和 TX 预加重，实现长距离传输，支持 HDCP2.3/1.4 加密和解密模块，支持微秒级别的低延时，完成兼容性等相关测试，完成发布参考设计原理图和相关固件	方案设计阶段	自主研发

注：以上在研项目均由公司研发团队执行。2022 年 1 月 1 日起，上述在研项目公司计划投入金额合计约为 8,009 万元。

自成立以来，公司时刻关注下游市场需求，把握行业发展动态，聚焦于技术研发，积累了一系列具有自主知识产权的科技成果，并成功将科技成果产品化与产业化，通过为下游客户提供优质的产品和服务，实现了科技成果与产业进行深度融合。未来，公司将继续加大技术研发和产品创新力度，拓宽产品应用领域，通过芯片方案的迭代升级推动产业整体的发展。

2、核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

（1）查阅了行业法律法规及国家政策文件，分析发行人是否符合国家科技创新战略的相关要求；

（2）查阅了行业专业机构出具的研究报告，了解发行人在境内与境外发展水平中所处的位置和细分行业领域的排名情况；

（3）查阅了容诚出具的审计报告，了解发行人的研发投入情况，并核查其归集情况；

（4）查阅了发行人研发项目资料，访谈了发行人研发技术人员和研发管理人员，了解发行人先进技术应用形成的产品（服务）和产业化情况，以及发行人保持技术不断创新的机制安排和技术储备；

（5）实地或视频走访了发行人的主要客户，了解发行人的市场认可程度。

3、核查意见

经核查，保荐机构认为：

发行人所处行业符合国家科技创新战略，且发行人科技创新能力突出、科技成果转化能力突出、行业地位突出、市场认可度高，符合《申报及推荐规定》第四条规定的符合科创板支持方向。

（三）发行人符合科创行业领域的核查情况

1、公司符合科创板行业领域及其依据情况

公司主营业务为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的

“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”之“新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业，是国家重点发展的战略性新兴产业之一。

因此，发行人属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021年4月修订）第四条“新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”高新技术产业和战略性新兴产业领域的企业。

2、核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

（1）保荐机构查阅了《申报及推荐规定》以及相关公开行业研究报告，了解了科创板相关行业范围；

（2）访谈了发行人高级管理人员，了解了发行人所处的行业、主要经营的业务以及相关的行业上下游情况；

（3）实地查看了发行人主要经营场地并获取了解了发行人主要产品，对比了发行人所处行业与相关科创板行业范围；

（4）通过公开资料查阅了同行业可比公司的行业领域归类情况。

3、核查意见

经核查，保荐机构认为：

发行人属于《申报及推荐暂行规定》第四条规定的行业领域，发行人主营业务与所属行业领域归类匹配，与可比公司行业领域归类不存在显著差异。

（四）发行人符合科创属性相关指标的核查情况

1、发行人符合科创属性相关指标的情况

（1）最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例5%以上，或者最近3年研发投入金额累计在6,000万元以上；其中，软件企业最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例10%以上；

2019年、2020年和2021年，公司研发投入分别为3,141.51万元、3,705.69万元和4,923.67万元，占营业收入的比例分别为30.05%、27.30%、21.04%；公司最近3年研发投入金额累计为11,770.87万元，占最近三年累计营业收入比例为24.81%，不低于5%。公司不断进行现有产品的升级及新产品的研究与开发，各期研发投入保持在较高水平，且呈现出逐年增长的趋势。

综上，公司符合《申报及推荐规定》第五条中“最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例5%以上，或者最近3年研发投入金额累计在6,000万元以上”的规定。

（2）研发人员占当年员工总数的比例不低于10%

截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日，发行人研发人员分别为96人、97人和107人，发行人员工总数分别为131人、143人和159人，发行人研发人员占当年员工总数的比例分别为73.28%、67.83%和67.30%，符合《申报及推荐规定》第五条中“研发人员占当年员工总数的比例不低于10%”的规定。

（3）形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5项以上，软件企业除外

截至2021年12月31日，发行人拥有已形成主营业务收入的境内发明专利54项，境外发明专利35项，符合《申报及推荐规定》第五条中“形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5项以上”的规定。

（4）最近3年营业收入复合增长率达到20%，或者最近一年营业收入金额达到3亿元。采用《科创板发行上市审核规则》第二十二条第二款第（五）项上市标准申报科创板发行上市的发行人除外

发行人2019年、2020年及2021年的营业收入分别为10,454.77万元、13,574.15万元及23,406.53万元，最近三年营业收入复合增长率为49.63%；发行人的营业收入符合《申报及推荐规定》第五条第（四）款“最近3年营业收入复合增长率达到20%，或者最近一年营业收入金额达到3亿元”的要求。

2、核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

(1) 取得并审阅容诚出具的审计报告，对研发人员和财务人员进行访谈，取得并核查发行人的研发投入归集明细情况及准确性、营业收入确认准确性，计算发行人报告期研发投入占比；

(2) 取得并核查发行人的员工花名册、了解发行人员工分类，研发人员的认定标准及实际执行情况、研发人员工时表和各主要研发项目的人员情况，以及研发部门设置与职责情况；抽样检查研发费用的归集及核算情况，核查研发费用内控制度是否健全并得到有效执行；

(3) 取得并核对了发行人的专利注册证书；在专利局网站上查询了发行人的专利，调取了专利局档案文件，在裁判文书网、中国执行信息公开网检索了发行人涉及的诉讼等纠纷；取得了发行人出具的知识产权不存在限制及纠纷的说明；访谈了发行人相关研发技术人员，了解了发行人主要产品所对应的发明专利、核心技术的应用情况；

(4) 取得并审阅容诚出具的审计报告，对发行人主要客户进行函证、现场及视频走访，核查销售收入真实性，了解行业经营情况；对发行人进行资金流水核查和销售收入穿行测试，核查发行人收入真实性和增长情况，计算发行人营业收入增长比例。

3、核查意见

经核查，保荐机构认为，发行人符合《申报及推荐暂行规定》第五条规定的科创属性相关指标。

(五) 关于发行人符合科创板定位的结论性意见

经充分核查和综合判断，本保荐机构认为发行人出具的专项说明和披露的科创属性信息真实、准确、完整，发行人符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标等科创属性要求；发行人符合科创板定位要求。

八、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件

(一) 发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的发行条件

1、发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，持续经营三年以上，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责

本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的主体资格进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：核查了发行人设立至今相关的政府批准文件、营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商设立及变更登记文件、股本变动涉及的增减资协议、股权变动涉及的股权转让协议、股权转让款支付凭证、主要资产权属证明、相关董事会和股东大会决议文件、发起人和主要股东的营业执照（或身份证明文件）、发行人开展生产经营所需的业务许可证照或批准等文件资料；对发行人、主要股东进行了访谈，并向发行人律师、审计师和评估师进行了专项咨询和会议讨论。

经对发行人主体资格的尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

（1）发行人的依法设立

发行人系由龙迅有限全体股东作为发起人，将公司从有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2015年8月31日，FENG CHEN、陈贵平、赛富创投、红土创投、兴皖创投、Lonex、芯财富、海恒集团、陈翠萍、夏洪锋、苏进、汪瑾宏、王从水、左建军和王平作为发起人共同签署了《发起人协议》，并根据华普天健会计师事务所出具的会审字[2015]2603号《审计报告》，以截至2015年3月31日经审计的账面净资产值3,078.0541万元，按照1:0.50626933比例折为1,558.3244万股，每股面值人民币1.00元，超出股本部分计入资本公积。发行人于2015年8月31日召开创立大会暨第一次临时股东大会，于2015年9月18日领取了安徽省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913400007950924118）。

因此，发行人系依法设立的股份有限公司，其设立的程序、资格、条件、方式等符合中国法律的规定。

（2）发行人的持续经营

发行人系由有限责任公司经审计的净资产折股整体变更为股份公司，有限责任公司成立于2006年11月29日，截至本上市保荐书出具之日，发行人的持续经营时间在3年以上，符合《科创板首发管理办法》第十条第一款之规定。

（3）发行人的组织机构及运行情况

发行人自设立以来，已按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定，建立健全了股东大会、董事会和监事会；选举了董事、独立董事、监事，聘任了董事会秘书、财务负责人等高级管理人员；董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等董事会下属专门委员会；设置了人力行政部、财务部、物流采购部、质量管理部、市场部、研发部等职能部门和机构；制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司治理制度。

发行人董事会由 9 名董事组成，其中独立董事的比例不低于三分之一。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等下属专门委员会，并聘任 1 名董事会秘书。

发行人监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

股东大会是发行人最高权力机构，由股东组成，代表股东的利益，按照法律、法规和规范性文件及发行人公司章程的规定行使权利。发行人的股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会应每年召开一次，临时股东大会按照规定在必要时召开。

根据保荐机构对发行人成立以来股东大会、董事会、监事会会议记录及决议的适当核查，发行人均能按照有关规定召开股东大会、董事会和监事会会议，会议的召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并保存有关会议文件；对董事、监事及其他高级管理人员的任免、关联交易用途等事项均能按照规定程序召开。

综上，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定。

2、发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且被有效执行

本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》等法规的要求对发行人的会计基础和内部控制制度进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：对经审计的财务报告及经审核的内部控制鉴证报告以及其他相关财务资料进行了审慎核查；查阅了报告期内重大购销合同、主要税种纳税资料以及税收优惠或财政补贴资料，并走访了银行等部门；就发行人财务会计问题，本机构与发行人财务人员和审计师进行密切沟通，并召开了多次专题会议

经对发行人的会计基础和内部控制制度的尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

发行人会计基础工作规范，公司财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，无虚假记载，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2022]230Z0215）。

发行人已建立规范、健全的内部控制管理体系，涵盖了发行人生产经营运作的全过程，使发行人全部经营活动中的各项业务均有了规范的内部控制制度或管理办法。发行人现有的内部控制制度涵盖了治理结构、业务运营、财务管理等方面，在完整性、合理性和有效性方面不存在重大缺陷，并将根据发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进。

2022年2月28日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留结论的《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0246），发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

发行人符合《科创板首发管理办法》第十一条之规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力

本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》等要求对发行人的业务完整性和独立持续经营能力进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：核查了发行人的业务经营情况、境内重要资产的权属证明、境外重要资产的境外法律意见书、相关三会决议文件、关联交易管理制度、劳动人事制度、工资管理制度、财务管理制度、主要股东的工商档案等文件资料；查阅了报告期内重大合同、关联交易协议相关资料，并走访了发行人的部分客户、供应商；查阅了董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员的履历资料及任职文件，并向其进行了问卷调查，并向发行人律师、审计师进行了专项咨询和会议讨论。

经对发行人的业务完整性和独立持续经营能力的尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

（1）发行人的资产完整和独立性

第一，资产完整情况。发行人拥有独立完整的研发、运营及销售服务体系。发行人合法拥有商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的研发和销售渠道。发行人拥有的资产权属清晰、完整，不存在被实际控制人占用而损害公司利益的情形。

第二，人员独立情况。发行人的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。发行人的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职。发行人的劳动、人事及工资管理与实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。

第三，财务独立情况。发行人已建立独立的财务核算体系、配备了独立的财务人员、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人未与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

第四，机构独立情况。发行人依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，建立健全了包括股东大会、董事会及其专门委员会、监事会等的法人治理结构。发行人聘请了包括总经理、财务负责人、董事会秘书等在内的高级管理人员，并根据自身经营管理特点和需要设置了相关职能机构或部门，各部门分工明确，运作正常有序。发行人独立行使经营管理职权，与实际控制人及其控制的其他企业机构不存在机构混同的情形。

第五，业务独立情况。发行人拥有独立完整的研发体系和市场营销体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。发行人的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

(2) 发行人最近 2 年主营业务，董事、高级管理人员及核心技术人员的变化情况和股权情况

发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人控股股东、实际控制人 FENG CHEN 和受控股股东、实际控制人控制的员工持股平台以及与 FENG CHEN 签署《表决权委托协议》的股东邱成英所持的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

(3) 发行人的股权情况

截至本上市保荐书出具之日，发行人控股股东、实际控制人为 FENG CHEN 先生。最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

综上，发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人控股股东、实际控制人所持的发行人股份，受实际控制人控制的股东所持发行人的股份，以及与发行人签署《表决权委托协议》的股东所持股份均权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《科创板首发管理办法》第十二条之规定。

（4）发行人的其他重大事项

1) 经核查，发行人拥有的与业务经营有关的重要商标、专利、专有技术等重要资产和技术的获得或者使用不存在重大权属纠纷；

2) 经核查，发行人不存在重大偿债风险，也不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项；

3) 经核查，发行人的经营环境和行业地位均保持良好，预计未来也不会发生重大变化，不会对发行人的持续经营构成重大不利影响；

4) 经核查，发行人不存在其他可能对发行人持续经营构成重大不利影响的情形。

发行人的上述情形符合《科创板首发管理办法》第十二条之规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策

本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的生产经营进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：取得了税务、工商等相关政府部门出具的证明；查阅了董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员的履历资料及任职文件，并向其进行了问卷调查；对发行人律师、审计师进行了专项咨询和会议讨论。

经对发行人生产经营的尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

发行人主营业务为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发、设计及销售。发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

最近 3 年内，发行人及其实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

综上，发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《科创板首发管理办法》第十三条之规定。

综上所述，发行人符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件。

（二）发行人符合发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元的规定

经核查，发行人本次发行前股本总额为 5,194.4146 万元，本次拟发行股份不超过 1,731.4716 万股（行使超额配售权之前），本次发行后公司股本总额大于 3,000 万元。

（三）发行人符合公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上的规定

经核查，本次拟发行股份不超过 1,731.4716 万股，发行后公司股本总额不低于人民币 6,925.8862 万元，公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上，符合上述规定。

（四）发行人市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求标准

1、发行人本次上市选择的标准

发行人符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第一项的上市标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

2、发行人预计市值符合上市标准

基于发行人报告期内的外部融资对应的估值情况，以及可比公司在境内外市场的估值情况等对发行人市值进行预先评估，预计发行人上市市值将满足前述上市标准。

3、发行人财务指标符合标准

根据容诚出具的《审计报告》（容诚审字[2022]230Z0215），发行人 2020 年、2021 年的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别

为 1,029.16 万元和 7,103.72 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元；此外，发行人 2021 年度营业收入为 2.34 亿元，大于 1 亿元。

综上，公司满足《上市规则》第 2.1.2 条第（一）项规定的市值及财务指标。

（五）上海证券交易所规定的其他上市条件

经核查，本机构认为发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

事项	安排
（一）持续督导事项	在本次发行结束当年的剩余时间及以后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； 2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	1、督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； 2、在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理办法》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； 2、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项； 3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、督导发行人执行已制定的《对外担保管理办法》等制度，规范对外担保行为； 2、持续关注发行人为他人提供担保等事项； 3、如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
（二）保荐协议对保荐机构权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员列席发行人的股东大会、董事会和监事会会议，对上述会议的召开议程或会议议题发表独立的专业意见； 2、指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员定期对发行人进行实地专项核查。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	1、发行人已在保荐协议中承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作，及时、全面提供保荐机构开展保荐工作、发表独立意见所需的文件和资料； 2、发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构并督促其协助保荐机构在持

事项	安排
	续督导期间做好保荐工作。
(四) 其他安排	无

十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

保荐代表人：魏先勇、占海伟

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

邮编：100004

电话：（010）6505 1166

传真：（010）6505 1156

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

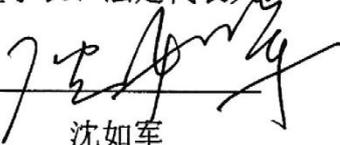
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

本机构作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，按照《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会的有关规定，通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，并与发行人、发行人律师及发行人审计师经过充分沟通后，认为发行人具备首次公开发行股票并在科创板上市的基本条件。因此，本机构同意保荐龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。

（以下无正文）

（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市保荐书》之签章页）

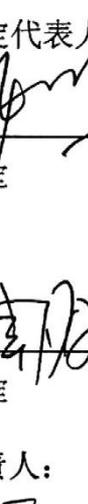
董事长、法定代表人：



沈如军

2022年4月25日

首席执行官：



黄朝晖

2022年4月25日

保荐业务负责人：



孙雷

2022年4月25日

内核负责人：



杜祎清

2022年4月25日

保荐业务部门负责人：



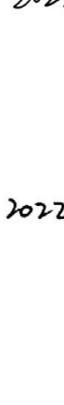
赵沛霖

2022年4月25日

保荐代表人：



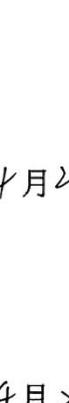
魏先勇



占海伟

2022年4月25日

项目协办人：



刘剑峰

2022年4月25日

保荐机构公章

中国国际金融股份有限公司

2022年4月25日